

令和7年11月1日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会
会長 嶋田 勇三

第235定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第235回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。

今回は会場とWEB会議システム（Zoomウェビナー）を利用してのハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和7年11月21日（金）定例講演会 13:00～16:45
技術交流会 17:00～19:00

2. 開催方式：ハイブリッド方式

【慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎 大会議室+WEB会議システム「Zoomウェビナー」】
(Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします)

慶應義塾大学 日吉キャンパス：神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1

<https://www.keio.ac.jp/ja/maps/hiyoshi.html>

3. プログラム：“最新iPhone17の実装とそれを支える技術”

| | |
|---------------------------------|---|
| | 『各種温度プロファイルとその効果』 (1) 13:00～14:00 プログラムテーマ① 河合 一男 氏 講演内容：最近の基板設計の要求から従来のはんだ付け規格では対応できにくい問題が発生している。また、量産現場でのコスト競争の要求はますます強くなっている。本講演では、特殊な温度プロファイルや工法の変更によるコストと品質の提案を行う。 従来から使われている JEITA の温度プロファイルの ΔT を重視することでの対応が難しく（微細部品等のボイド、リワークおよび微細部品と通常サイズの部品の混載）なっている。 提案事例（混載基板の一括リフロー化） ①多ピンコネクターのはんだ付け、②耐熱性の低い分部品等の一括リフロー化、③皮膜熱線のリフロー化 |
| (2) 14:00～14:15 テクノロジーフィーチャー | 『はんだ付け用途以外のリフロー炉導入事例のご紹介』 アントム（株）営業開発部 部長 兼 副工場長 栗田 享 氏 講演内容：リフロー炉の主用途は基板実装工程でのはんだ付けが挙げられる。はんだ付けに基板を“比較的の低温（400°C以内）”で“均一に加熱”する能力が求められるが、同様の設備能力はいろいろな分野で求められている。本講演では、半導体・電子部品製造工程や樹脂硬化用途、医療器具やTシャツのプリント等、多様な業種・工程にリフロー炉が活用されている事例をご紹介する。 |
| (2) 14:15～14:35 テクノロジーフィーチャー | 『千住金属工業のパワー半導体向け接合材料について』 千住金属工業（株）研究開発部 ハンダテクニカルセンター 研究員 篠崎 敬佑 氏 kshinozaki@senju.com 講演内容：脱炭素化や省エネルギー化の推進を狙って、次世代材料を用いて製造した高効率なパワー半導体の活用が広がっている。本講演ではそういった次世代パワー半導体向けに同社が取り扱っているダイボンド用接合材料を紹介する。 |
| 14:35～14:45 | － 休憩 － |
| (3) 14:45～15:45 プログラムテーマ② | 『半導体パッケージング検査治具技術動向』 CCTECH JAPAN（株）マーケティングオフィス エンジニアリングマネージャー 竹内 進 氏 講演内容：本講演では、半導体パッケージング検査に関するテストソケットの種類と導電ラバーシートの特徴、製造プロセス、電気的特性とメカ的特性と使用用途について紹介する。 ○導電シートの種類、○製造プロセスの要点、○電気的特性と押し込み加重、○現在の使用用途 |

| | |
|------------------------------|--|
| (4) 15:45～16:45 プログラムテーマ③ | 『スマートフォン・iPhone 17 シリーズに見る最新技術』 セミコンサルト 代表 上田 弘孝 氏 講演内容 : 2007年初代 iPhone2G の登場以来、来年で 20 年。そして 2027 年は Apple CEO だった故 Steven Jobs 氏が特別な幹部にのみ明かした「30 年技術ロードマップ」の最終年を迎える。折り畳み型 iPhone、Apple Glass、そしてパソコンを置き換えそうな新たな smart computer 等のベースとなる半導体パッケージや実装技術が、iPhone17 series において、少し姿を現しているようだ。 本講演では、iPhone17 Air における小型化・薄型化の実装技術を、iPhone17 Pro Max ではベア基板技術の変化、0.3mmピッチ実装の現状、小型電子部品の採用状況などを概説する。 |
| 17:00～19:00 | － 技術交流会 － 藤山記念会館 1F 「エプロント慶應日吉店」にて |

4. 参加費

会員 : 無料 企業正会員は 1 社 3 名まで (Web 会議特例 : 3 名を超える参加者については事務局に問い合わせください)。また、同じ名前とメールアドレスで複数人の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1 登録 1 名様のご利用でお申込みください。
 会員外 : 22000 円／人 (不課税) (お申し込み後、請求書をお送りします)

5. 参加申し込み

会員 : 会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙 (企業正会員には登録代表者 (連絡担当者) にお送りしています) にご記入の上、E-mail にてお申し込みいただけますようお願いします。

※今回、会場と Zoom ウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外 : ホームページのお問い合わせフォーム (<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>) より「お問い合わせ内容」の項目に「第 235 回定例講演会参加希望」と参加方式 (会場もしくは Zoom) をご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前と E-mail アドレスもご記入ください。

申込締切日 : 会員 令和 7 年 11 月 11 日 (火)

会員外 令和 7 年 11 月 10 日 (月)

※講演 2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようにお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※今年度から講演資料は、当会ホームページの会員のページ (<https://www.j-jisso.org/member/>) に講演日までにアップいたします。ID と PW が必要ですので講演日前までにご確認ください (企業正会員は貴社連絡担当者にご確認下さい)。今年度より資料の郵送はいたしません。

会員外の方はクラウドで資料共有をいたします。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。